

株主メモ

事業年度 1月1日から12月31日まで

定時株主総会 3月

基準日 定時株主総会 12月31日
剰余金の配当 期末 12月31日
中間 6月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先・照会先 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号(〒541-8502)
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
電話(通話料無料) 0120-094-777

公告の方法 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。
(<http://www.daiichi-seiko.co.jp>)
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ホームページのご案内

<http://www.daiichi-seiko.co.jp>

第一精工

検索

最新のトピックスをはじめ、業績報告や会社情報などをわかりやすくご案内してまいります。



株主・投資家情報ページ



DAI-ICHI SEIKO REPORT

過去最高の売上高を達成 「ダントツ商品」で未来を拓く

代表取締役社長 小西 英樹



Q 第53期(平成27年12月期)の業績について

まず、電気・電子部品事業は、これまで好調を維持してきたアンテナ用超小型RF同軸コネクタがスマートフォン市場の成長鈍化の影響で伸び悩みましたが、細線同軸コネクタはパソコンの新モデルへの搭載が進み堅調に推移しました。FFC/FFCコネクタ関連も製品ラインアップの拡充が奏功しデジタル家電やパソコン、スマートフォンでの採用が進んだことから伸びました。また、HDD関連部品はサーバーやゲーム機向けが引き続き堅調でした。

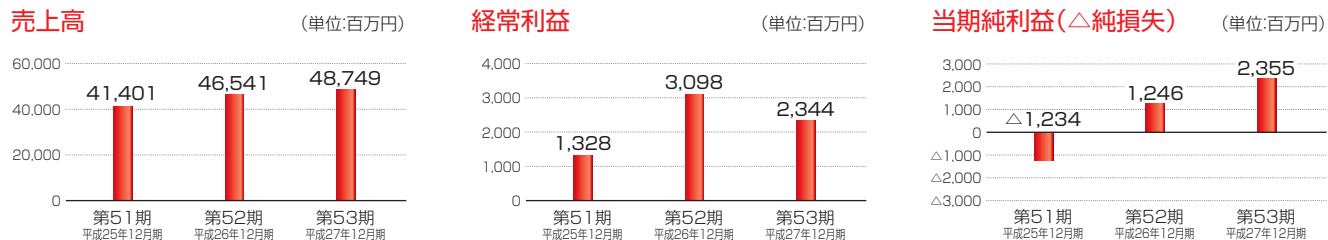
次に、自動車部品事業は、中国での自動車販売の伸び悩みはありましたが、北米を中心に自動車市場全体としては拡大傾向

が続いたことに加え、自動車の電装化の進展や環境意識の高まりから燃費向上や排出ガス抑制に寄与する車載用センサが伸びました。また、LEDヘッドライトや各種電子制御向けの車載用自社ブランドコネクタについても搭載車種が更に拡大し、順調に推移しました。

設備事業は、パソコン向けが伸び悩む中、車載向けの半導体製造に使われる樹脂封止装置や金型の受注が堅調でした。また、スマートフォン等の半導体パッケージ製造に使われる自動テープ貼付機が好調を維持しました。

以上により、売上高は過去最高の487億円を計上することができました。また、経常利益は、研究開発費の増加により前期との比較で減益となりましたが、当期純利益は増益となりました。

業績ハイライト



これらの結果や経営環境等を総合的に勘案し、前期に引き続き期末配当金を1株当たり10円、中間配当を含む年間配当金を15円とさせていただきます。

Q 第54期(平成28年12月期)の重点戦略について

電気・電子部品事業

主力製品である超小型RF同軸コネクタや細線同軸コネクタの拡販を継続するとともに、Board to BoardコネクタやFFC/FFCコネクタを中心に、次世代高速伝送対応やノイズ対策に優れた小型の高性能コネクタを市場に投入し、業績の向上に努めます。また、新たにロボットや医療・介護分野を成長市場と位置付け、事業拡大に向けた取り組みを進めます。HDD関連部品は、生産の最適化を継続し、顧客満足度の更なる向上とシェア拡大を図ります。

自動車部品事業

自動車市場の更なる拡大とともに環境対策や安全走行へのニーズが高まることが予想され、自動車電装部品の受注が将来的に増加すると考えられますので、こうした需要増に備えるため生産拠点の拡充と生産能力の増強を図ります。車載用自社ブランドコネクタは、カーエレクトロニクス分野で部品や機能の統合が進むと思われることから、これに対応する新製品の開発、拡販に注力し、事業の更なる拡大に努めます。

設備事業

差別化した独自技術を活用し、半導体メーカー等と共同で市場ニーズの拡大が見込まれる超薄型成形技術の開発、試作に組み込み、封止装置や金型等の拡販を行います。また、封止装置で培った成形技術を応用した新規ビジネスを開拓し、収益基盤の強化を図ります。

新規事業への取り組み

昨年新たな取り組みとしてご紹介したロボット産業向けのトルクセンサ「エストルク」が、モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「2015年“超”モノづくり部品大賞」において機械部

品賞を受賞しました。トルクの検出に*世界で初めて静電容量方式を採用して構造をシンプルにしたことで、従来方式のセンサと比べて小型軽量化と大幅なコストダウンを実現した点が受賞に繋がりました。既に産業用ロボットや介護機器など幅広い分野でエストルクの評価が進んでいますし、量産に向けた準備も整いましたので、今年から本格的に販売を開始します。今回の受賞を機にロボット市場参入に弾みがつくものと期待しています。

また、圧電薄膜を用いた3軸加速度MEMSセンサを搭載した地震感知器も商品化に目途がつかましたので、こちらも今年から量産販売を開始します。

Q 未来への取り組みについて

今後の成長を確実なものとするために何が必要かを考え、過去の成長期に何が起こっていたかを分析すると、必ず大ヒット商品の存在があります。当社の過去を振り返ると、細線同軸コネクタCABLIN-VSが2009年にディスプレイの規格団体からノートパソコンの世界標準品に認定されたことで、業界での知名度と売上レベルを一気に押し上げ、現在もなお売れ続けています。

このような「ダントツ」の商品、具体的には各事業の売上の2割以上を稼ぎ出すような、未来の看板商品を生み出し、育てる必要があります。これを実現するために外部との協業や提携も含めた積極的な研究開発と投資を行ってまいります。

既に未来の「ダントツ商品」候補第一弾を市場に送り出したので、これらを看板商品に育てるとともに、新たな商品開発を継続し、持続的な成長に繋げてまいります。

株主の皆様には今後とも当社グループへのご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。

*当社調べ

来期計画	売上高	530億円
	経常利益	25億円
	親会社株主に帰属する当期純利益	17億円

電気・電子部品事業

コネクタ及び同関連部品

主にスマートフォンやタブレットなどのポータブル電子機器向けに、コネクタ(接続部品)を開発・製造し、アイペックスブランドで世界市場に展開しています。常に最先端技術や規格の調査・研究を行い、それらに適合する製品をいち早く開発し、市場をリードすることに力を入れており、ディスプレイ高精細化規格Embedded Display Port™(eDP™)や、薄型機器の高速化に対応する規格M.2(NGFF)など新たな規格を採用する電子機器に当社の細線同軸コネクタや高周波アンテナコネクタが多数採用されています。また、落下や振動に強いロック機構付のFPC/FFCコネクタや需要の伸びが期待されるBoard to Boardコネクタもラインアップし、電子機器のみならず、自動車や医療機器などの分野においてもお客様の幅広いご要望にお応えします。



主要製品

- スマートフォン、携帯電話等移動体通信市場向け製品群
- デジタル家電、スマートメーター市場向け製品群
- パソコン、タブレット市場向け製品群
- 高速無線通信アンテナ市場向け製品群
- ウェアラブル、カーインフォテイメント、メディカル市場向け製品群



未来のダントツ

***業界初! 独自の完全シールド構造による次世代高速伝送対応コネクタを発売!**

高速伝送による高周波ノイズの干渉をシャットアウト

*当社調べ

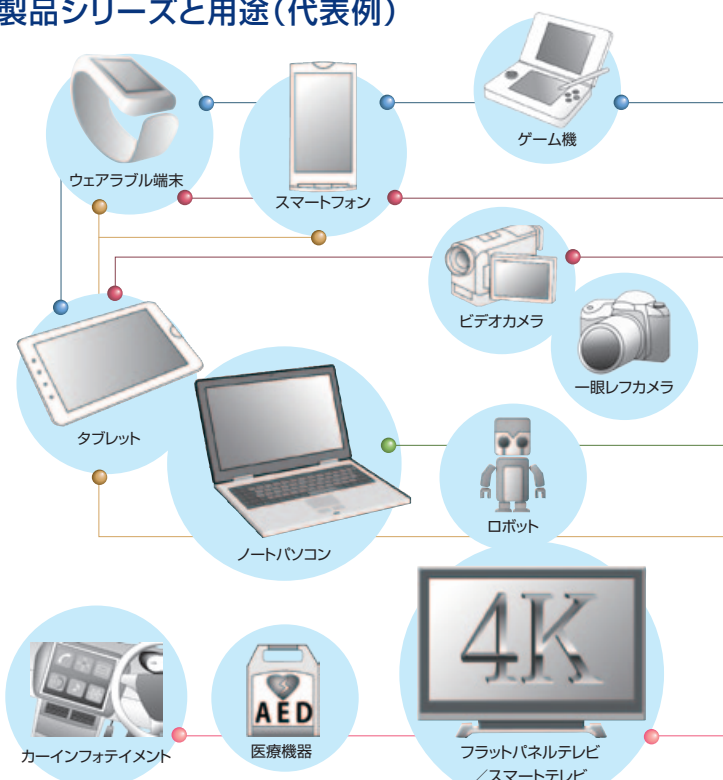


細線同軸コネクタ CABLINEX®CAII



Board to Boardコネクタ NOVASTACK®35-HDP

製品シリーズと用途(代表例)



超小型RF同軸コネクタ MHF®シリーズ

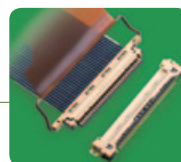


スマートフォン、タブレットなどのモバイル機器のほかルーターやサーバーなどの高速無線通信用アンテナとして使用されるコネクタ。



FPC/FFCコネクタ MINIFLEX™シリーズ

ロック機構によるケーブル保持力とスペース効率に優れた、主にモバイル機器やカメラなどに使用される小型・低背コネクタ。



細線同軸コネクタ CABLINEX®シリーズ

高速・大容量伝送に優れ、主にタブレット、ノートパソコンの液晶ディスプレイとメイン基板を繋ぐ用途に使用されるハイスペックコネクタ。



Board to Boardコネクタ NOVASTACK®シリーズ

省スペース設計により、主にスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器内部の基板と基板を繋ぐ(Board to Board)用途に使用されるコネクタ。



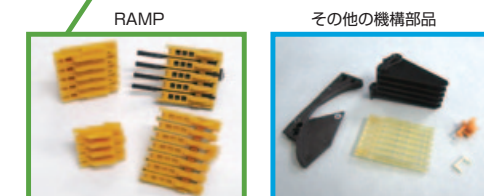
FPC/FFCコネクタ EVAFLEX®シリーズ

オートロック機構によるケーブル接続の容易さと独自構造による接触信頼性の高さから、主にフラットパネルテレビや車載向けに使用されるコネクタ。

※CABLINEX, MHF, EVAFLEX, MINIFLEX, NOVASTACKは当社の商標、登録商標です。
VESA, DisplayPort, eDPはVideo Electronics Standard Associationの商標、登録商標です。

エレクトロニクス機構部品(HDD用機構部品等)

クラウド化によるデータセンター向けのサーバーや、パソコン、フラットパネルテレビ、カーナビ、ゲーム機などの記憶装置として、HDD(ハードディスクドライブ)には今後も根強い需要が見込まれています。高速化と省電力に優れたSSD(ソリッドステートドライブ)を組み合わせたハイブリッドドライブがウルトラブックやサーバーで搭載が進んでいるほか、大容量化と省電力を実現するヘリウム充填タイプも現在注目を浴びています。当社は、顧客との共同開発により世界で初めて量産化に成功した超精密樹脂部品RAMP(磁気ヘッド用ガイド部品)など、進化が続くHDDに不可欠の機構部品を国内外のメーカーに供給しています。



主要製品

- HDD市場向け製品群
- デジタル家電市場向け製品群

自動車部品事業

クルマは今や、電子機器の集合体といっても過言ではありません。低燃費性能や排気ガス対策、そして安全な快適走行のために過酷な条件下でも高い性能を保つ高感度センサが必需品となっています。また、衝突回避装置や自動運転技術の導入に伴い益々電子制御化が進むクルマには他の電子

機器同様、コネクタ(接続部品)など様々な電子部品が多数使用されています。当社は、センサ部品やコネクタをはじめ制御ユニットなど、精密金型と生産技術を駆使した様々な部品を供給しています。



各種センサ

回転、圧力、加速度、電流等の車載用センサ部品は、当社が長年培ってきた金属部品等をインサートし、一体成形する技術を応用した自動車電装部品事業の主力製品です。排気ガス規制対応や、燃費性能、安全性能の向上に貢献するこれらの製品群は、今後も需要の伸長が期待されます。



主要製品

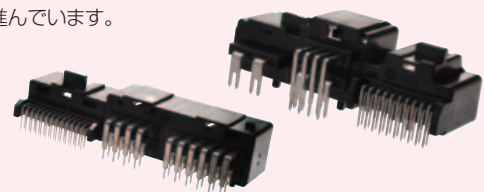
- 制御支援用の電子補助部品全般
- センサ ● スイッチ ● コネクタ ● 制御ユニット等
- その他
- カード型スマートキー

製品TOPICS

ECU用PCBコネクタ



アイベックスオートモーティブ・ブランドで供給しているECU(電子制御ユニット)向けコネクタは、業界規格(USCAR/EWCAP)に準じた複数のPCBコネクタを一体化したタイプのコネクタです。一体化による部品点数削減、作業性向上やコスト削減への貢献を高く評価いただき、北米を中心に電子制御ユニットでの使用が進んでいます。



設備事業

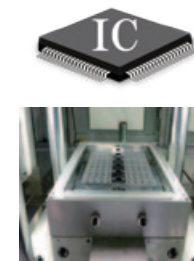
1980年、当社は精密金型技術を活かし、世界で初めて全自動半導体樹脂封止装置を発売しました。以来、国内外のお客様に装置を納入すると共に技術の向上を図り、現在では半導体製造関連装置、シリコン樹脂成形装置、及び樹脂成形周辺機器なども供給しています。変化の速い市場において、お客様の様々なご要望に高効率、高品質ソリューションでお応えし、パソコン、モバイル、車載、LEDなどの幅広い業界で実績と信頼を積み重ねています。

主要製品

- 半導体製造装置
 - 半導体樹脂封止装置 (全自動・半自動・マニュアル)
- 半導体製造関連装置
 - 全自動テープ貼付/剥離装置
- シリコン樹脂成形装置
- 樹脂成形周辺機器
 - 射出成形用周辺機器



GP-PRO SP170(170t)
全自動半導体樹脂封止装置



半導体封止用金型



GP-PRO sf120
全自動半導体樹脂封止装置



VIOSIS-LED
シリコン樹脂成形装置



S-Pot
卓上型成形機



TS-PRO
MAP QFN用テープ貼付装置



GC6-415HV
ゲートカットロボット

トルクセンサ「エストルク」が「2015年“超”モノづくり部品大賞」機械部品賞を受賞

モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「2015年“超”モノづくり部品大賞」において、当社の「静電容量型トルクセンサ“ESTORQ™”（エストルク）」が機械部品賞を受賞しました。エストルクは、各種ロボットや自動組立装置の回転動作時に発生するトルク（ねじり力）を検出し、制御するためのセンサで、トルクの検出方法として*世界で初めて静電容量方式を採用しました。静電容量方式は、従来の歪ゲージ式のトルクセンサと比べてシンプルな構造とすることができるため部品数の削減、小型軽量化と大幅なコスト削減を実現することが評価され、今回の受賞に至りました。今後、協働ロボットや介護ロボットなどの実用化に大きく貢献することが期待されます。また、ロボット以外にも自動車や工作機械など様々なニーズにお応えするためのラインアップの拡充も進めています。

*当社調べ

未来のダントツ
*世界初! 静電容量型トルクセンサ



Electrostatic Capacitance Torque Sensor
ESTORQ™

モノづくり部品大賞



山梨第二工場が竣工

自動車産業では運転支援システムの導入などにより車載用センサやコネクタの需要が伸長することが見込まれています。このような需要増に伴う増産に対応するため山梨工場敷地内で建設を進めていた第二工場が完成し、2015年11月に竣工式を行いました。第二工場の完成によって工場延床面積は従来の約2倍となり、車載用センサやコネクタの生産能力も約1.5倍に拡張されるなど、車載用部品の生産・供給能力が大幅に増強されます。



福岡ソフトバンクホークスのオフィシャルスポンサーに

当社の主要拠点である福岡で絶大な人気を誇る福岡ソフトバンクホークスとスポンサー契約を締結しました。本拠地ヤフオクドームに広告を出すことで、野球ファンの皆様をはじめメディアへの露出機会を増やし、当社の知名度やブランド浸透を図ってまいります。



ちやんとつくる
DAHCHI SEIKO

Official Sponsor

©Softbank HAWKS



POINT

過去最高の売上高を達成。積極的な研究開発投資を行いつつ、最終利益は前期との比較で大幅な増益に。

連結貸借対照表（要旨）

（単位：百万円）

科目	当期	前期
	平成27年12月31日現在	平成26年12月31日現在
資産の部		
流動資産	32,163	34,562
固定資産	27,019	24,298
有形固定資産	25,884	23,247
無形固定資産	419	300
投資その他の資産	716	750
資産合計	59,183	58,860
負債の部		
流動負債	9,498	9,793
固定負債	3,869	4,060
負債合計	13,367	13,854
純資産の部		
株主資本	44,293	42,188
資本金	8,522	8,522
資本剰余金	8,046	8,046
利益剰余金	27,723	25,619
自己株式	△ 0	△ 0
その他の包括利益累計額	1,466	2,768
少数株主持分	55	49
純資産合計	45,815	45,006
負債純資産合計	59,183	58,860

連結損益計算書（要旨）

（単位：百万円）

科目	当期	前期
	平成27年1月1日から平成27年12月31日まで	平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
売上高	48,749	46,541
売上原価	35,116	33,809
売上総利益	13,633	12,731
販売費及び一般管理費	11,909	10,621
営業利益	1,723	2,110
営業外収益	712	1,115
営業外費用	90	127
経常利益	2,344	3,098
税金等調整前当期純利益	2,344	3,098
法人税等合計	△ 18	1,849
少数株主利益	7	2
当期純利益	2,355	1,246

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

（単位：百万円）

科目	当期	前期
	平成27年1月1日から平成27年12月31日まで	平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,448	6,857
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,028	△ 4,618
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 549	△ 952
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 189	506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 1,318	1,792
現金及び現金同等物の期首残高	14,042	12,250
現金及び現金同等物の期末残高	12,724	14,042

株式の状況

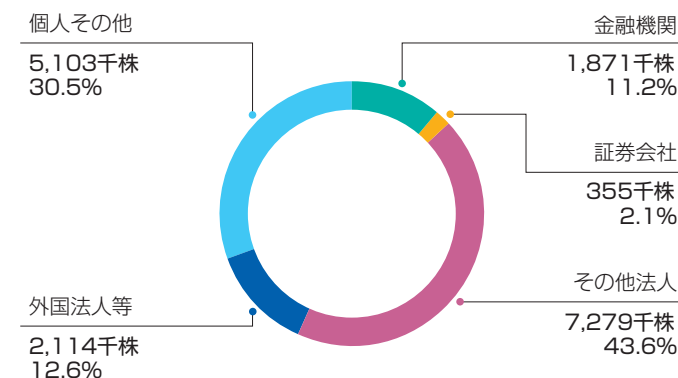
（平成27年12月31日現在）

発行可能株式総数 20,000,000株
 発行済株式の総数 16,722,800株
 株主数 5,946名
 大株主（上位10名）

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社ディー・エム・シー	7,200,300	43.05
第一精工従業員持株会	720,180	4.30
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	550,900	3.29
小西英樹	496,600	2.96
CACEIS BANK LUXEMBOURG-CLIENT ACCOUNT	350,200	2.09
小西達也	240,000	1.43
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	234,400	1.40
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	227,500	1.36
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	169,687	1.01
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	168,200	1.00

所有者別株式分布状況

（平成27年12月31日現在）



会社概要

（平成27年12月31日現在）

商号 第一精工株式会社
 設立 昭和38年7月10日
 本社所在地 〒612-8024 京都市伏見区桃山町根来12番地4
 資本金 85億2,269万円
 従業員数 単体:1,682人 連結:5,923人
 主要取引銀行 京都銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行

役員

（平成28年3月30日現在）

代表取締役社長 小西英樹
 専務取締役 福元哲巳
 常務取締役 土山隆治
 常務取締役 緒方健隆
 常務取締役 原田康利
 取締役 後藤信明
 取締役 遠藤隆吉
 取締役 原昭彦
 取締役 岡田和廣*
 取締役 橋口純一*
 常勤監査役 庭野修次*
 監査役 角田宗熙*
 監査役 中田均治*
 監査役 前出吉治*

*(社外)

配当金の推移

